

# Klej do płytek F-100

## ZASTOSOWANIE:

KLEJ DO PŁYTEK F-100 jest cementową zaprawą klejącą, przeznaczoną do przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych (glazura, terakota, klinkier, gres, mozaika porcelanowa), płytek cementowych i lastrykowych, płytek z nienasiąkliwego kamienia naturalnego oraz aglomeratów kamiennych. Zalecany na powierzchnie balkonów, tarasów, elewacji oraz na podłożach wykonanych w systemie ogrzewania podłogowego lub ściennego. Podłoże mogą stanowić: tynk cementowy, cementowo-wapienny i gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy i anhydrytowy, a także surowa powierzchnia wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych i wapienno-piaskowych. Ze względu na zwiększoną elastyczność i przyczepność zaprawa nadaje się także do układania płytek na powierzchni starej glazury i terakoty, pozostałościach silnie przylegających klejów i zapraw cementowych, lastryko, płytach gipsowo-kartonowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz; warstwa o grubości 2-10 mm.

## WŁAŚCIWOŚCI:

KLEJ DO PŁYTEK F-100 jest specjalną zaprawą klejącą, produkowaną jako gotowa, sucha mieszanka najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych środków modyfikujących. Odnacza się zwiększoną elastycznością i plastycznością, dzięki czemu po związaniu jest odporna na odkształcenia, jakie występują w okresie eksploatacji w układzie warstw: podłoże-zaprawa klejąca-płytką (np. na elewacjach budynków, tarasach, w systemach ogrzewania podłogowego

i ściennego). Zgodny z zaleceniami, optymalny dobór konsystencji i grubości warstwy sklejania (dla danych warunków stosowania zaprawy), eliminuje efekt spływu świeżo przyklejonej płytki. KLEJ DO PŁYTEK F-100 jest wyrobem mrozo- i wodoodpornym. Obniżony spływ pozwala przyklejać płytki „od góry” - właściwa konsystencja i grubość warstwy eliminują spływ kleju. Umożliwia to rozpoczęcie prac od góry ściany i uniknięcie przyklejania docinanych płytek na jej eksponowanej powierzchni. Wchodzenie na okładzinę i rozpoczęcie fugowania możliwe jest po około 24 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po 3 dniach. Podane właściwości obowiązują dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 23°C i 55% wilgotności oraz standardowych płytek układanych na dobrze przygotowane podłoże.

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być suche, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Nierówności podłoża, które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy Kleju F-100 (2-10 mm), należy korygować używając materiałów zalecanych do tego typu prac, na przykład: ZAPRAWY CEMENTOWEJ. Nadmierną chłonność podłoża należy zredukować, stosując preparat gruntujący np. X-Grunt, żelowy Drop Stop lub głęboko penetrujący Royal Grunt Premium.

## PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY:

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji) 0,23-0,25 l wody na 1 kg suchej zaprawy [5,75-6,25/25 kg] i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tą najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin.



# Klej do płytek F-100

## SPOSÓB UŻYCIA:

KLEJ DO PŁYTEK F-100 stosuje się w cienkowarstwowej metodzie układania płytek. Należy nanieść go na przygotowane podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje właściwości klejące przez około 30 minut (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). Po rozprowadzeniu zaprawy, należy przyłożyć płytkę i dokładnie docisnąć ją do podłoża. Ilość zaprawy наносzonej na podłoże powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem była równomierna i możliwie jak największa (min. 2/3 powierzchni płytki). W przypadku płytek układanych na podłogach oraz okładzin wykonywanych na zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była całkowita. Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut od momentu jej dociśnięcia. Jeżeli zaplanowano fugowanie okładziny, to w trakcie wykonywania prac należy ze spoin na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy klejącej, pojawiającej się przy dociskaniu płytek. Wchodzenie na posadzkę lub fugowanie okładziny można rozpocząć po stwardnieniu zaprawy, nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni. Nie należy moczyć płytek przed klejeniem! Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

## ZUŻYCIE:






Średnio zużywa się 1,5 kg zaprawy na 1 m<sup>2</sup>, na każdy 1 mm grubości warstwy sklejenia. W praktyce zużycie zależne jest od stopnia równości podłoża i rodzaju zastosowanych płytek.

## PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

KLEJ DO PŁYTEK F-100 należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, na paletach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku.

## GWARANCJE I UWAGI:

Producent nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją na opakowaniu. W przypadku reklamacji wymagane jest zachowanie opakowania i dowodu zakupu produktu. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika oraz na stronie [www.franspol.com.pl](http://www.franspol.com.pl).

-  Grubość warstwy 2-10 mm
-  Mrozo i wodoodporny
-  Lekki ruch pieszy po 24 godzinach
-  Ogrzewanie podłogowe i ścienne
-  Zwiększona elastyczność i plastyczność

